

5 Minute Epoxy

14250 – 25 ml

Descrição	Adesivo / Encapsulante de cura rápida para propósitos gerais																																						
Uso Pretendido	Cola metais, tecido, cerâmica, vidro, madeira e concreto (em combinações)																																						
Características do Produto	100% reativo, sem solventes. Boa resistência a solventes. Cola metais, tecidos, vidros, madeira e concreto.																																						
Limitações	Nenhuma																																						
Propriedades Físicas Típicas	<p>Os dados devem ser considerados somente representativos ou típicos e não devem ser usados para finalidades do projeto.</p> <p>Após 7 dias de cura a 75°F (24°C)</p> <table><tr><td>Teste de Adesão</td><td>2-3 pli</td></tr><tr><td>Resistência ao Impacto</td><td>5.5 ft. lb/in²</td></tr><tr><td>Tensão de Alongamento</td><td>1%</td></tr><tr><td>Dureza</td><td>85 Shore D</td></tr><tr><td>Preenchimento de Lacuna</td><td>Boa</td></tr><tr><td>Resistência Dielétrica</td><td>490 volts/mil</td></tr><tr><td>% Sólidos por Volume</td><td>100</td></tr><tr><td>Tensão de cisalhamento do Adesivo</td><td>1900 psi @ 0.005" linha de aderência</td></tr><tr><td>Volume Específico</td><td>25.1 in³/lb</td></tr></table> <p>Não Curado</p> <table><tr><td>Cor</td><td>Âmbar claro</td></tr><tr><td>Viscosidade de Mistura</td><td>10000 cps</td></tr><tr><td>Taxa de Mistura por Volume</td><td>1:1</td></tr><tr><td>Taxa de Mistura por Peso</td><td>1:1</td></tr><tr><td>Densidade da Mistura</td><td>9.17 lbs/gal :1.10 gm/cc</td></tr><tr><td>Tempo de Trabalhabilidade</td><td>3 – 6 min.</td></tr><tr><td>Tempo de Fixação</td><td>10 - 15 min</td></tr><tr><td>Cura Funcional</td><td>¾ - 1 hr @ 22 °C</td></tr><tr><td>Cura Total</td><td>12 hr</td></tr><tr><td>Temperatura de Serviço</td><td>Seco: -4 a 93.3 °C</td></tr></table>	Teste de Adesão	2-3 pli	Resistência ao Impacto	5.5 ft. lb/in ²	Tensão de Alongamento	1%	Dureza	85 Shore D	Preenchimento de Lacuna	Boa	Resistência Dielétrica	490 volts/mil	% Sólidos por Volume	100	Tensão de cisalhamento do Adesivo	1900 psi @ 0.005" linha de aderência	Volume Específico	25.1 in ³ /lb	Cor	Âmbar claro	Viscosidade de Mistura	10000 cps	Taxa de Mistura por Volume	1:1	Taxa de Mistura por Peso	1:1	Densidade da Mistura	9.17 lbs/gal :1.10 gm/cc	Tempo de Trabalhabilidade	3 – 6 min.	Tempo de Fixação	10 - 15 min	Cura Funcional	¾ - 1 hr @ 22 °C	Cura Total	12 hr	Temperatura de Serviço	Seco: -4 a 93.3 °C
Teste de Adesão	2-3 pli																																						
Resistência ao Impacto	5.5 ft. lb/in ²																																						
Tensão de Alongamento	1%																																						
Dureza	85 Shore D																																						
Preenchimento de Lacuna	Boa																																						
Resistência Dielétrica	490 volts/mil																																						
% Sólidos por Volume	100																																						
Tensão de cisalhamento do Adesivo	1900 psi @ 0.005" linha de aderência																																						
Volume Específico	25.1 in ³ /lb																																						
Cor	Âmbar claro																																						
Viscosidade de Mistura	10000 cps																																						
Taxa de Mistura por Volume	1:1																																						
Taxa de Mistura por Peso	1:1																																						
Densidade da Mistura	9.17 lbs/gal :1.10 gm/cc																																						
Tempo de Trabalhabilidade	3 – 6 min.																																						
Tempo de Fixação	10 - 15 min																																						
Cura Funcional	¾ - 1 hr @ 22 °C																																						
Cura Total	12 hr																																						
Temperatura de Serviço	Seco: -4 a 93.3 °C																																						
Preparação da Superfície	Limpe a superfície com solvente e retire qualquer tipo de graxa, óleo, sujeira e outros contaminantes. A superfície também pode ser limpa com equipamentos de limpeza industrial, como vaporizadores. Nos metais, desbastar a superfície para aumentar a área de aderência e aumentar a resistência do adesivo.																																						
Instruções de Mistura	<p>Buscar uma mistura homogênea da resina e do endurecedor para uma ótima cura e aderência</p> <p>25 ml (Dev-Tube)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aperte o material em um recipiente do tamanho de um cinzeiro2. Usando o bastão misturador, mexa vigorosamente os componentes por 1 minuto3. Imediatamente aplique no substrato																																						

Instruções de Aplicação

Aplique a mistura diretamente na superfície

1. Monte a parte a ser colada dentro do tempo de trabalhabilidade
2. Pressione as duas partes a fim de evitar lacunas e assegurar um bom contato. (um pequeno filete do epóxi deve escorrer pelas bordas para garantir o preenchimento)

Para lacunas muito grandes:

1. Aplique o epóxi em ambas as superfícies
2. Espalhe para cobrir toda a área

Deixe os conjuntos colados curarem antes de manuseá-los.

Não deixar cair, bater ou carrear com muita carga.

Armazenamento

Armazenar em ambiente quente e seco.

Complacências

Nenhuma

Resistências Químicas

As resistências químicas são verificadas após 7 dias de cura, em temperatura ambiente [30 dias de imersão a 75°F (24°C)].

Amônia	Fraco
Acetona	Falho
Ácido Clorídrico 10 %	Fraco
Querosene	Excelente
Óleo de Motor	Excelente

Isopropanol	Fraco
Etanol	Fraco
Óleo de Corte	Excelente
Ácido Sulfúrico	Fraco

Precauções

Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto.

Para assistência técnica, favor chamar TELEFONE (55)11-5535.4211

SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL

Garantia

Devcon® irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.

Retratação

Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em teste de laboratório e não é pretendido para a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma representação ou garantia à respeito destes dados.

Outras Informações

Revisão 00 06/12/2005
ITW Devcon 06/06/2002